

Automatisiertes Handling beim Depaneling LPKF erleichtert die Integration von Lasermaschinen in die Linie

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-
widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF

Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand:

Dr. Götz M. Bendele (CEO)
Christian Witt (CFO)

Aktie:

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» [Weitere Pressemeldungen](#)

Leiterplatten sauber, schnell und ohne Belastung des Materials zu schneiden, ist für eine effiziente PCB-Produktion unerlässlich – und wird mit modernen Lasermaschinen hervorragend umgesetzt. LPKF geht jetzt noch einen Schritt weiter: Zusammen mit seinen State-of-the-art Laser-Nutzentrennsystemen bietet der Lasertechnologie-Experte nun auch Lösungen für das Handling der Leiterplatten vor und nach dem Schneidprozess an.

Darauf haben viele PCB-Produzenten gewartet: Speziell auf die Anforderungen des Nutzentrennens hin ausgerichtete Automatisierungslösungen. LPKF führt den Laser-Depaneling-Prozess, der durch seine hohe Qualität und Geschwindigkeit überzeugt, damit konsequent weiter und denkt dem Bedarf der Anwender voraus. Die Lasermaschine für das Nutzentrennen wird komplett mit einer automatisierten Zuführung und Entladung geliefert, die den hohen Ansprüchen der modernen PCB-Produktion entspricht. Das neue Automationsangebot ergänzt die Depaneling-Systeme LPKF CuttingMaster 2000 und 3000 sowie LPKF MicroLine 2000.

Mit der flexiblen Lösung hat der Maschinennutzer nun für den gesamten Depaneling-Prozess einen Ansprechpartner, der aus einer Hand gleichermaßen Handling und Depaneling betreut. Somit entfallen die sonst oft aufwändigen zusätzlichen Kommunikationswege zu oder zwischen Dienstleistern. Die Anwendung wird noch schneller und einfacher.

Flexibel und bedarfsgenau: Automatisiertes Handling

Für große und kleine, bestückte und unbestückte Leiterplatten in jeglicher Form und Kombination wird das modular konzipierte Handling jeweils flexibel und genau auf die Kundenanforderungen hin zugeschnitten. Die hauseigene Automationseinheit kann dabei mit einem variablen Cobot ausgestattet werden. Applikationsspezifisch kommen verschiedene Träger- und Greiferlösungen zum Einsatz. Sie werden so ausgelegt, dass sie alle beim Anwender eingesetzten unterschiedlichen Nutzenlayouts handhaben können; auch das Absammeln der Leiterplatten in kundenspezifische Blister ist möglich.

Sowohl für die Massenfertigung als auch für die High-Mix-Low-Volume-Fertigung bietet LPKF passende Lösungen. Die Bandbreite des Portfolios reicht von der Ergänzung einzelner Module bis hin zu einer komplett autonomen Insellösung für den gesamten Nutzentrenn-Prozess. Auch eine Integration in SMT-Linien ist einfach umsetzbar.

Dank optimal konzipierter Software und der Kommunikation über SMEMA- bzw. optionale Hermes-Schnittstellen integrieren sich Laser-Nutzentrenn-Systeme von LPKF nahtlos in vorhandene und neue Fertigungsumgebungen sowie Manufacturing Execution Systeme (MES).

Durch diesen Ansatz sorgen die Systeme für einen reibungslosen Produktions- sowie Datenfluss. Dies ermöglicht darüber hinaus eine weitestgehende Transparenz und Kontrolle der Produktion. Für die zunehmende Automation und die Anforderungen von Industrie 4.0 sind sie somit perfekt ausgestattet.

Insgesamt sind die Handling-Lösungen von LPKF speziell auf den Nutzentrennprozess ausgelegt. Wie beim Schneidprozess selbst werden sie den höchsten Anforderungen an Qualität, Kosteneffizienz und Flexibilität gerecht.

Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Website des Unternehmens: <https://www.lpkf.com/de/automatisiertes-handling>

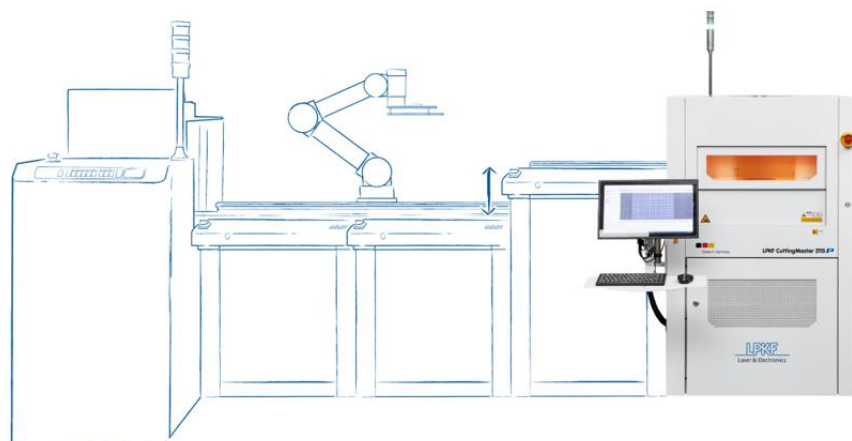


Abb. 1: Der LPKF CuttingMaster kann optional mit einer Automationslösung und/oder einem variablen Cobot ausgestattet werden.



Abb. 2: Mit Hilfe eines Cobots werden die Panels vor dem Schneiden auf einem speziell dafür vorgesehenen Träger positioniert und anschließend davon abgesammelt. Hohen Durchsatz ermöglicht der Einsatz von zwei Trägern, die im Wechsel eingesetzt werden und so die Bearbeitung zweier Prozessschritte gleichzeitig erlauben.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.